

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **118 (2000)**

Heft 6

PDF erstellt am: **23.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



CD

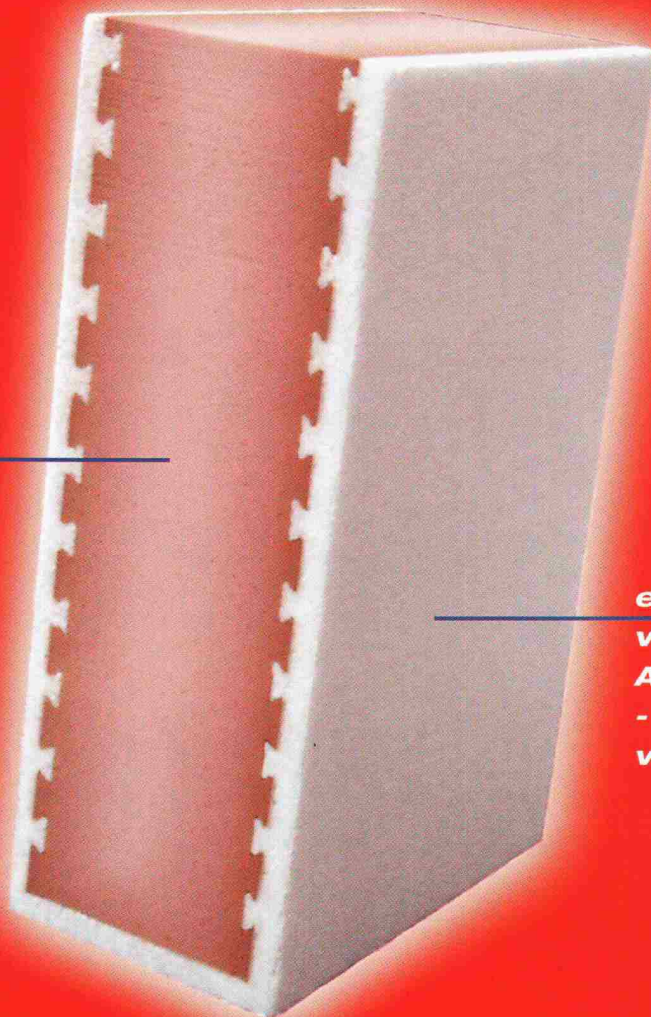


KO2



Microchip

NEW GENERATION



heavy
hochverdichteter
Kern bringt
dieselbe
Wärmedämm-
wirkung mit nur
ca. der Hälfte
der Plattenstärke

easy
verputzbare
Aussenschicht
- problemlos
verarbeitbar

HiCompact[®]

Die hochverdichtete Wärmedämmung der neuen Generation schafft das bisher Unmögliche und komprimiert das Dämmvermögen im Verhältnis 1 : 1,8. Planern und Architekten bringt HiCompact[®] Aussen und Innen mehr Freiraum. Den Bauherren mehr Nutzfläche bei geringeren Gesamtkosten.



gonon
Isolation AG (SA)
CH-8226 Schleithelm
Telefon 052/680 17 21

www.hicompact.ch